



# 中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 604—2006

---

## 金基厚膜导体浆料

Gold based thick film conductor pastes

2006-05-25 发布

2006-12-01 实施

---

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

## 前 言

本标准的附录 A 为资料性附录,附录 B、附录 C 为规范性附录。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由贵研铂业股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人:李世鸿、金勿毁、范顺科、魏丽红、余青智、杜红云、严先雄。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准首次发布。

# 金基厚膜导体浆料

## 1 范围

本标准规定了金基厚膜导体浆料的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及订货单内容。

本标准适用于厚膜混合集成电路、传感器等器件用的金基厚膜导体浆料(以下简称金浆)。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 17473.1	厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法	固含量测定
GB/T 17473.2	厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法	细度测定
GB/T 17473.3	厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法	方阻测定
GB/T 17473.4	厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法	附着力测定
GB/T 17473.5	厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法	粘度测定
GB/T 17473.7	厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法	可焊性、耐焊性试验

## 3 定义

下列定义适用于本标准。

**金基厚膜导体浆料** gold based thick film conductor paste

由超细金粉、超细钯粉、无机添加物、有机载体等组成的满足于印刷或涂敷的膏状物。

## 4 要求

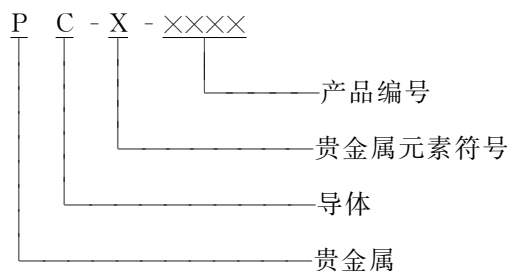
### 4.1 产品分类

4.1.1 金浆按产品的用途分为导体金浆、焊接金浆。

4.1.1.1 导体金浆用于厚膜混合集成电路、传感器等器件,用作导带和电极等。可以在陶瓷、玻璃等基体上烧结形成附着力。

4.1.1.2 焊接金浆用于传感器电极引线的焊接。只能在贵金属基体上或贵金属化的陶瓷(玻璃)基体上烧结形成附着力。

4.1.2 导体金浆的牌号标记方法如下:



示例 1: PC-Au-4910 表示编号为 4910 的导体金浆。

示例 2: PC-AuPd-9310 表示编号为 9310 的添加有钯的导体金浆。